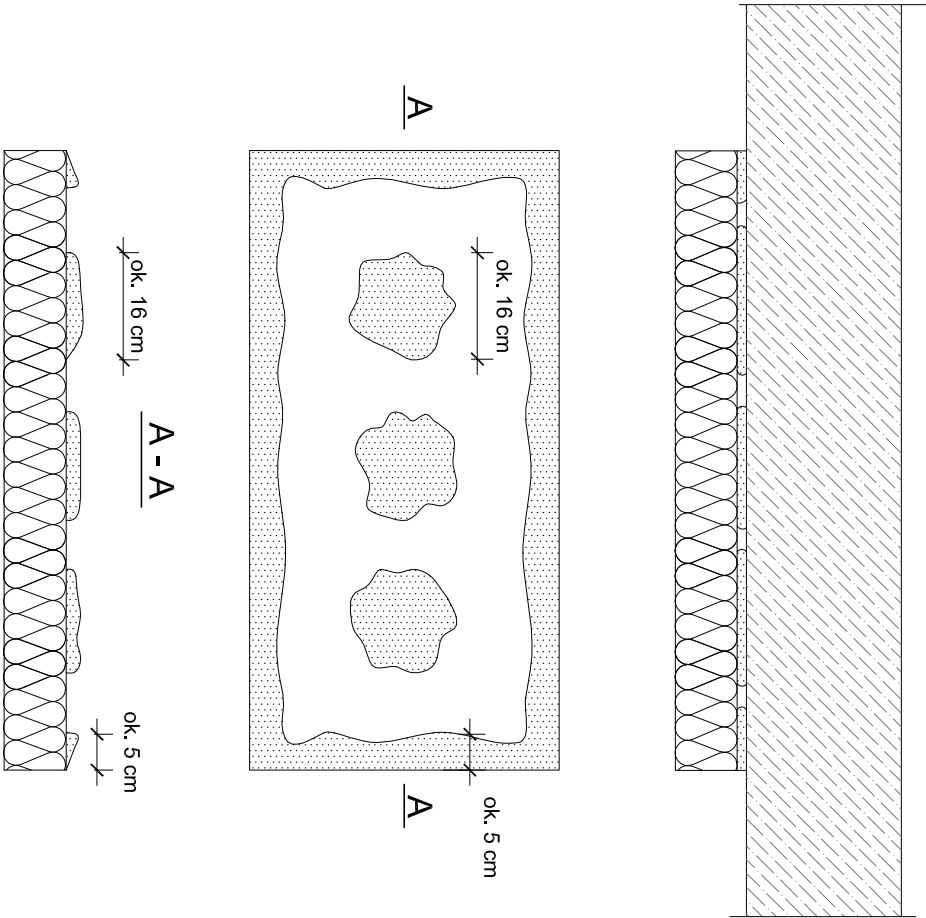


SZCZEGÓŁY WYKONANIA TERMOIZOLACJI ŚCIAN

Sposób klejenia styropianowych płyt izolacji termicznej.



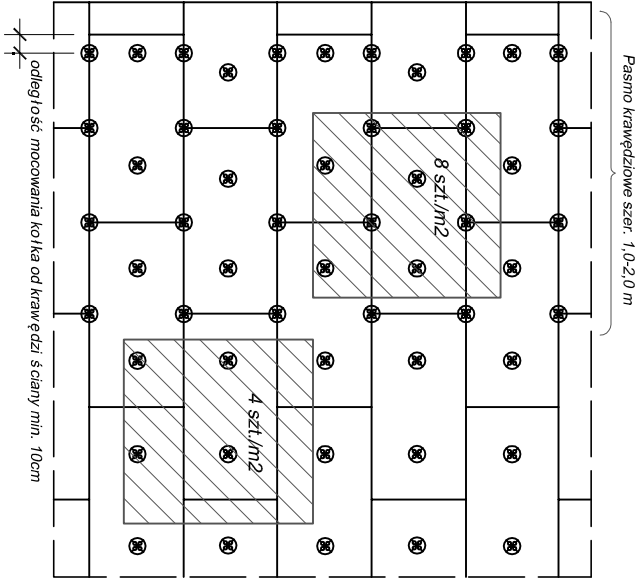
$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% \geq 40 \%$$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

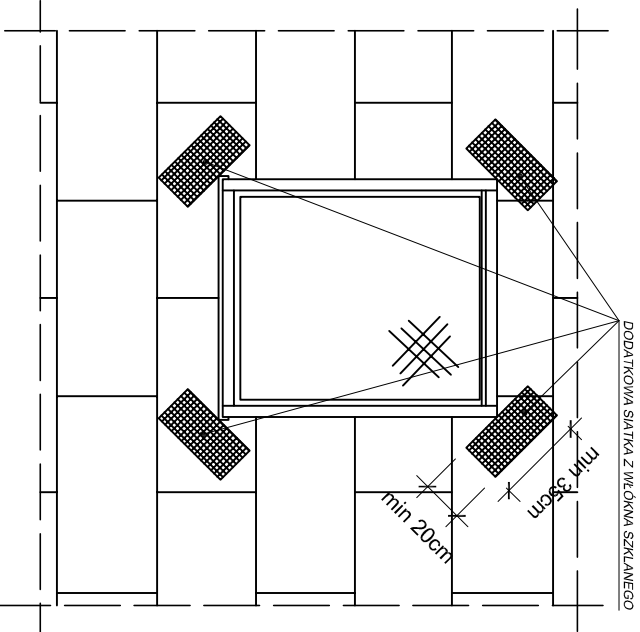
Do klejenia izolacji termicznej używać fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody obwodowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować różnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nanieść minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termozależną całopowierzchniowo przy użyciu pacy zębalej (ok. 10 mm).


ROZMIESZCZENIE KOŁKÓW NA ŚCIANIE



szerokość budynku	pasmo krawędziowe
do 8 m	1,0 m
od 8 do 16 m	1,5 m
powyżej 16 m	2,0 m

WZMOCNIENIE OTWORÓW ŚCIANY



<div><div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>mgr inż. Mirosław Łopato</div></div></div><div>77-100 BYTÓW ul. Jana Pawła II 7/3 tel. 602217314</div></div>				TEMA: ROZBUDOWA WJEĆIA WODY w m. GOMULINO dz. nr 642/4	
INWESTOR: P. W. i K. Sp. z o.o. ul. Kortuska12 83-340 Sieradowice					
PROJEKTOWAŁ:		NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	SKALA:	
mgr inż. PIOTR SZUKAŁA		BK.IIF-7342/1311/97		—	
OPRACOWAŁ:		NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA:	
inż. KRZYSZTOF PINKERT		—		PAŹDZIERNIK 2014	
NAZWA RYSUNKU:				RYS. NR	
SZCZEGÓŁY WYKONANIA TERMOIZOLACJI ŚCIAN				K-10	